

钨铜合金电子封装与热沉材料

产品名称	钨铜合金电子封装与热沉材料
公司名称	乐清市前沿合金材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市经济开发区纬十六路268号（乐清市强生电子有限公司内）
联系电话	86 0577 62711260 13216015505

产品详情

公司专业生产w-cu电子封装材料及管棒材，以下是w-cu电子封装材料的具体介绍：既具有钨的低膨胀特性，又具有铜的高导热特性，尤为可贵的是，其热膨胀系数和导热导电性能可以通过调整材料的成分而加以设计，因而给该材料的应用带来了极大的方便。我们采用高纯的优质原料，经压制成形、高温烧结及熔渗后，得到性能优良的w-cu电子封装材料及热沉材料。适用于与大功率器件封装的材料，如基片、下电极等；高性能的引线框架；军用和民用的热控装置的热控板和散热器等。

优点:具有与不同基体相匹配的热膨胀系数及高的热导率；优良的高温稳定性及均一性；优良的加工性能；

产品规格:w-cu板，最大尺寸500x300毫米，厚度0.04-50mm。

不同成分w-cu电子封装材料的性能

材料组份 (wt%)	w-10cu	w-15cu	w-20cu	w-25cu	w-30cu
比重 (g/cm3)	17.1	16.4	15.5	14.8	14.2
热导率 (w/m.k)	191	198	221	235	247
热膨胀系数 (× 10-6/k)	6.3	7.1	7.6	8.5	9.0

批发解棚发详情请
联系卖家